

## dMCS 台式 PXIe 测控系列

### HW-1093dM(G2)

符合 PXIe/PXI 总线标准规范  
国产台式加固 PXIe 测控平台  
全铝镁合金加固设计  
支持 19" 标准机架式安装  
内置厚物科技 PXIe-9170 控制器  
内置厚物科技 3U 9 槽 PXIe 背板  
1 个 3U PXIe 系统槽和 8 个 3U PXIe/PXI 混合扩展槽  
系统槽带宽 8GB/s, 3 个 4GB/s 扩展槽和 5 个 2GB/s 扩展槽  
兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA 等 PXIe/PXI 模块  
10.1" 工业显示屏 1280x800 分辨率  
多点电容触摸屏  
面板提供 2 个千兆网口及 3 个 USB2.0 接口  
主动散热设计  
风扇转速可根据机箱内部温度高低实现自动调速  
工业设计外观简洁美观  
可实时监控系统电源、风扇、温度状态



HW-1093dM方案

#### 业界首款国产带触摸屏全铝镁合金 3U 9 槽 PXIe 加固台式测控平台

HW-1093dM(G2)是业界首款 10.1" 内置 Intel® Core™ 6<sup>th</sup> 或 9<sup>th</sup> 或 11<sup>th</sup> Gen i7 四核八线程或六核十二线程或八核十六线程 CPU 嵌入式 PXIe 控制器、PXIe 背板、多点电容触摸屏的全铝镁合金加固台式 PXIe 测控平台（支持 19" 标准机架式安装），适用于科研试验、自动化测试产线、测试设备台等工作场景。

HW-1093dM(G2)内置厚物科技 3U 9 槽 PXIe 背板，基于 PCIe Gen2.0 技术，符合 PXIe/PXI 总线标准规范，具有 1 个 PXIe 系统槽和 8 个 PXIe/PXI 混合扩展槽（兼容 PXIe 和 PXI 模块）。系统槽带宽 8GB/s，提供 3 个 4GB/s 专用带宽 PXIe/PXI 混合扩展槽和 5 个 2GB/s 专用带宽 PXIe/PXI 混合扩展槽，兼容高速数采、高速数字化仪、数字万用表、航空总线、FPGA、射频及开关等 PXIe/PXI 模块。此测控平台具有标准千兆网口和标准 USB 接口；主动式散热设计，支持 PWM 风扇转速控制，根据机箱内部温度高低风扇自适应调整转速对控制器及模块进行散热；集成有触摸功能的液晶显示屏，可实时显示系统软件状态及系统硬件状态信息等。

HW-1093dM(G2)充分利用 PXIe/PXI 总线稳定可靠、兼容性好、结构稳固、数据吞吐量大、性能高等特点，根据项目应用不同，此测控平台可内置各种不同的 PXIe/PXI 模块，实现微波射频、高速数字、信号仿真、原型验证、电压电流、温度频率、应力应变、振动冲击、音视频及各种航空总线接口等信号的测试测量，用户可以在此测控平台上快速搭建各种测量、测试及控制系统，适用于军工国防、航空航天、兵器电子、船舶舰载等实战应用场合和科学试验研究场合。

操作系统	Windows® 7 Professional （选项 1、选项 2）	
	Windows® 10 Professional （选项 1、选项 2、选项 3、选项 4、选项 5）	
处理器	Intel® Core™ 6 <sup>th</sup> Gen i7-6822EQ 2.0GHz (8MB Cache, up to 2.8GHz)	四核八线程（选项 1）
	Intel® Core™ 6 <sup>th</sup> Gen i7-6820EQ 2.8GHz (8MB Cache, up to 3.5GHz)	四核八线程（选项 2）
	Intel® Core™ 9 <sup>th</sup> Gen i7-9850HL 1.9GHz (9MB Cache, up to 4.1GHz)	六核十二线程（选项 3）
	Intel® Core™ 9 <sup>th</sup> Gen i7-9850HE 2.7GHz (9MB Cache, up to 4.4GHz)	六核十二线程（选项 4）
	Intel® Core™ 11 <sup>th</sup> Gen i7-11850HE 2.6GHz (24MB Cache, up to 4.7GHz)	八核十六线程（选项 5）
内存	16GB DDR4 （可升级为 32GB/64GB）	
存储	独创性双固态硬盘 SSD 设计：	
	1, NVMe 250GB SSD x1 （系统盘）（可升级为 1TB/2TB/4TB） 2, SATA3.0 1TB SSD x1 （数据盘）（可升级为 2TB/4TB/8TB）	

链路配置	配套控制器 PCIe Gen3.0 规范 2 Link 模式: PCIe3.0 x8 + PCIe3.0 x8
显示	10.1"工业显示屏, 1280x800 分辨率
触摸屏	多点电容触摸屏
背板	3U 9 槽 PXIe 背板, 基于 PCIe Gen2.0 技术 1 个 PXIe 系统槽和 8 个 PXIe/PXI 混合扩展槽 系统槽带宽 8GB/s, 第 2 槽到第 4 槽带宽均为 4GB/s, 第 5 槽到第 9 槽带宽均为 2GB/s
IO 接口	LAN x2, USB3.0 x4, USB2.0 x2, RS232 x1, DP x2, VGA x1, SMB x1, RESET x1, LED x4
散热	风扇支持 PWM 工作模式, 自适应调速, 主动散热, 符合 PXIe/PXI 总线标准规范
电源	500W, 工业级, AC 输入, 90VAC~264VAC, 47Hz~63Hz, 航插接头
环境	工作温度: 0°C ~ 50°C (常温级) 工作温度: -20°C ~ 60°C (宽温级) 存储温度: -40°C ~ 70°C 相对湿度: 5% ~ 95% (无凝露)
抗冲击	30G 峰值, 半正弦, 11ms 脉冲
抗振动	2.4Grms@5~500Hz (X、Y、Z 三方向各 1 小时)
尺寸	343.2 x 404.0 x 177.8 mm (不含把手及支撑脚)
重量	11.4KG (含厚物科技 PXIe-9170 控制器)
包装	定制配套包材
类型	dMCS 台式 PXIe 测控系列

**注意:** [由于产品定期升级, 如需更准确的规格配置信息, 请联系厚物科技 0755-29982022](#)